

第13回電子デバイスフォーラム京都プログラム

(KM-1 挨拶・基調講演:西地区4号館地下1階 バズホール、KM-2、A～Eコース:東地区1号館)

(敬称略)

10月29日(木)10:00-12:30	コース	10月29日(木)14:00-16:40	10月30日(金)12:35-14:50	10月30日(金)15:15-17:30
KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30 (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)	【A】 注目の 次世代インフラ	A-1 DC800V時代のデータセンター 戸所義博(イーセップ)/酒井滋樹(日新イオン機器) ◆AI/MLデータセンター800Vdc給電へ！その状況と課題について(仮題) 村 文夫 ◆次世代データセンタを支える電源インバージョンへDC800V時代におけるGrid to Core)全体最適への転換へ(仮題) ローム 横浜テクノロジーセンター 技術顧問 博士(工学) 財津 俊行 ◆ 柳村田製作所 皆川	A-2 進化するドローン産業 松浦正純(FLOSFIA)/山崎治(シャープフロンティアAT) ◆ドローンの市場動向と今後の展望(仮題) 柳インプレス ドローンジャーナル編集部/インプレス総合研究所 河野 大助 ◆ ◆物流ドローンの事業化と将来展望(仮題) 金沢工業大学 工学部航空宇宙学科 教授 赤沢 剛志	A-3 パワーデバイスの新しい応用 中村孝(大阪大学)/松浦正純(FLOSFIA) ◆炭素・宇宙開発のためのSiC CMOS集積回路・イメージセンサ(仮題) 広島大学 半導体産業技術研究所(RISE) 教授 黒木 伸一郎 ◆SiCパワーデバイスの超高温圧機器への応用(仮題) ネクスファイン・テクノロジ(株) 代表取締役 大阪大学大学院 工学研究科 中村 孝 ◆SiC MOSFETとGaNが変える電力変換：データセンターSSTから協働ロボット用ドライブまで(仮題) インフィニオン テクノロジーズ ジャパン(株) インダストリアル&インフラストラクチャー事業本部 マーケティング部 部長 藤森正然
司会:中村 孝(大阪大学) ◆来賓挨拶 京都府知事 (予定) 京都市長 (予定) ◆基調講演 「フラッシュメモリが切り拓くAI時代の未来とキオクシアの挑戦」 キオクシア(株) 執行役員 メモリ事業部長 井上 教史 ◆基調講演 「東レ 100年の歴史と半導体関連技術」 東レ(株) シニアフェロー 富川 真佐夫 ◆基調講演 「世界の半導体市場は異次元領域の爆発成長に入ったのだ！ ～シリコン列島ニッポンの誕生で、各社の設備投資が一気促進～」 ㈱産業タイムズ社 執行役 会長 泉谷 渉	【B】 先端技術の 現在地	B-1 京都発ヒューマノイドロボット 泉谷淳子(村田製作所)/平澤拓(Holoway) ◆ヒューマノイドロボット研究とその応用(仮題) 早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 教授 橋本 健二 ◆KyoHA概要/理事長挨拶および今後の活動、設立背景の説明など(仮題) 早稲田大学 理工学術院 教授 高西 淳夫 SREホールディングス(株) コンサルティング&テクノロジーソリューションズ事業本部 コンサルティング&ビジネスデベロップメント部門 コンサルティング部 部長 佐々木 啓文 ◆ヒューマノイドを支える電子デバイス技術(仮題) ㈱村田製作所 技術・事業開発本部 技術企画・新規事業推進統括部 新規事業推進2部 部長 山川 直子	B-2 サーマルエンジニアリング 平澤拓(Holoway)/泉谷淳子(村田製作所) ◆先端パッケージの放熱・冷却技術について 東京大学大学院工学系研究科附属 システムデザイン研究センター 先端デバイス研究部門 主幹研究員 高木 剛 ◆先端半導体パッケージの技術動向とチップ内冷却技術 ー 2.5D/3D集積からチップ内冷却(μ LHP)まで ー 慶應義塾大学理工学部 システムデザイン工学科 教授 多田 宗弘 ◆ヒートシンク技術とその進化について(仮題) ㈱WELCON 斎藤 隆	B-3 光通信技術・応用 橋詰泰彰(NTT)/酒井滋樹(日新イオン機器) ◆光トランシーバーによる光ネットワーク可視化技術(仮題) NTT(株) 笹井 健生 ◆光ネットワークにおける障害予測技術とその展望(仮題) 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 廣田 悠介 ◆オール光ネットワークのための遠隔制御対応光トランシーバー構成技術の取り組み状況(仮題) NTT(株) 妹尾 由美子
	【C】 The 半導体	C-1 AI時代の勝者を探る 山本浩之(マイクロン)/廣田良浩(ワイドヴィル) ◆「半導体デバイスの最先端」とは何か？ 微細化・3D化の歴史から考える 広島大学 半導体産業技術研究所 特命教授 青砥 なほみ ◆半導体市場と技術の動向最前線(仮題) ㈱SUMCO 小森 孝行 ◆AI時代の半導体業界を眺む(仮題) ㈱SBI証券 シニアアナリスト 和田木 哲哉	C-2 AI時代の半導体最前線を探る 山本浩之(マイクロン)/三富士道彦(ローム) ◆先端ロジック半導体デバイスの技術動向 東京大学工学系研究科 生産技術研究所 教授 小林 正治 ◆エンドポイントAIチップ”Solist-ATM”による機械設備等の異常の予兆検知(仮題) 低電圧 LSI開発本部 回路技術開発部 技術主幹 浜地 健次 ◆低電圧化により縦方向スケーリングが可能な3D強誘電体NAND (FeNAND)メモリ(仮題) マイクロンメモリアナリスト ㈱FELLOW-NAND PATHFINDING 合田 晃	C-3 装置・プロセス・実装技術がAI最前線を支える 森義弘(SCREEN)/廣田良浩(ワイドヴィル) ◆半導体製造装置メーカーの脱炭素への挑戦：SCREENのSBTI目標と環境負荷低減の取り組み(仮題) ㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ R&D戦略統括部 グリーン戦略部 環境サステナビリティスペシャリスト 中川 真一 ◆高速インフラ社会に貢献するプラズマプロセス技術(仮題) SPPテクノロジーズ(株) プロセスエンジニアリング部 シニアマネージャー 米倉 和賀 ◆AI技術を支える半導体メモリのスケーリングに向けたプロセスおよび材料の革新 東京エレクトロン(株) デバイス技術ソリューション企画部 メモリテクノロジプロジェクト エキスパート 大池 界
KM-2 マーケティングセッション 9:20-11:45 (受付 8:50 開始)	「AI時代の勝者を決めるのは、半導体だ」	D-1 技術・マーケットトレンド 森川泰宏(ULVAC)/藤原健典(東レ) ◆技術とトレンド・マケについて(仮題) ㈱SBRテクノロジー 代表取締役社長 西尾 俊彦 ◆次世代AI7xセラレータの技術フロンティア ー先端パッケージング、熱設計、CPOによるシステム統合進化ー 3DIGリサーチラボ合同会社 リサーチ&コンサルティング テクニカル・ディレクター 市川 公也	D-2 光電融合 不破保博(元ローム)/藤原健典(東レ) ◆AIシステムを支える先端パッケージ、電気・光インタフェース、CPO NVIDIA Corp. Principal Research Scientist 西 芳典 ◆光電コパッケージ技術の最新トレンドと高速光デバイスの進展 三菱電機(株) 光電融合デバイスプロジェクト プロジェクトマネージャー 大島 伸夫 ◆CPO向け光コネクタの動向とエコシステムの課題 センコーアドバンス(株) 新規事業開発室 先端技術営業 浅地 佑豪	D-3 先端PKG 不破保博(元ローム)/森川泰宏(ULVAC) ◆Si-Cap内蔵半導体基板技術(仮題) ㈱村田製作所 技術・事業開発本部 事業インキュベーションセンター IPaaS事業推進部 IPaaS開発5課 若岡 拓生 ◆3Dパッケージ向け仮固定材動向と当社の取り組み(仮題) 積水化学工業(株) 高機能プラスチックカンパニー エレクトロニクス戦略室 理事 開発戦略グループ長 江南 俊夫 ◆パネルレベルパッケージ向けデジタルリソグラフィシステム開発(仮題) ㈱ニコン 精機事業本部 次世代事業開発統括部 プロジェクト推進室 松橋 佑介
司会:廣田 良浩(ワイドヴィル) ◆特別講演 「今後の半導体・装置・電子部品市場見通し(仮題)」 ㈱産業タイムズ社 大阪支局 支局長 電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛 ◆特別講演 「2027年度以降のグローバル市場動向と注目すべき半導体市場の今後の見通し(仮題)」 インフォマインテリジェンス合同会社 シニアコンサルティングディレクター 南川 明 ◆特別講演 「テクノロジーハードウェア業界見通し:スマホなど完成品・AIサーバー需要見通し、FPDやCMOSセンサなど部品視点も」 みずほ証券株 エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジ ー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫	【D】 跳躍の最先端 パッケージ・ 実装技術	E-1 大学セッション(無料) [13:50-16:45] ARIM半導体分析の最前線 今本浩史(京都大学)/向井雅昭(京都工芸繊維大学) ◆超高温電子顕微鏡を用いた半導体・無機材料解析(仮題) 大阪大学 超高温電子顕微鏡センター 副センター長/教授 山崎 順 ◆ワイドギャップ半導体デバイスの高性能化に向けた異種材料接合と接合界面評価(仮題) 大阪公立大学大学院工学研究科 教授 重川 直輝 ◆配位高分子の光・熱電応答に基づく赤外線センシング 京都工芸繊維大学 材料化学系 教授 野々口 愛之 ◆生体/デバイス界面設計に基づく非侵襲生体内化学成分センシングデバイスの開発 山形大学 大学院有機材料システム研究科 教授 長峯 邦明	E-2 航空・宇宙技術の最前線 浦岡行治(NAIST)/竹本剛士(住友精密工業) ◆ ◆宇宙ビジネスの実務(仮題) TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 新谷 美保子 ◆航空機用熱交換器の開発動向 住友精密工業(株) 航空宇宙事業部門 フェロー 富田 進	E-3 やはり目が離せない！アジア半導体産業の動き中・韓・印 アジア半導体産業の最前線を追う！ 戸所義博(イーセップ) ◆中国・インド半導体産業の現在地(仮題) ㈱産業タイムズ社 代表取締役副社長 電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏 ◆広帯域幅メモリー(HBM)はAI時代の次なる進化を促す ～HBMをめぐる米中韓の市場競争戦～ ㈱産業タイムズ社 ソウル支局長 嚴 在韓
	【E】 特別セッション			